



Photocoupleur driver de grille Toshiba à courant de sortie crête 2,5A en boîtier bas-profil.

Dispositif ultra-mince garantissant un isolement de 5kV et des distances de fuite et de dégagement de 8.0 mm.

Düsseldorf, Allemagne, 19 avril 2018 - Toshiba Electronics Europe a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau photocoupleur driver de grille en boîtier SO8L bas-profil. Le TLP5832 fournit un courant de sortie crête de 2,5A (I_{OPH} , I_{OPL}) et peut piloter directement des IGBT ou des MOSFET de classe moyenne, dans certaines applications comme des onduleurs pour applications industrielles, de climatisation ou solaires, ou encore des servo-amplificateurs.

L'adoption du boîtier SO8L permet d'obtenir un dispositif de seulement 2,3 mm d'épaisseur, soit environ 54% de moins que les produits Toshiba actuels en boîtiers SDIP6 ou DIP8. Le boîtier SO8L convient bien aux applications modernes, au sein desquelles l'épaisseur et la place disponibles sont souvent limitées.

Malgré sa petite taille, ce CI offre une tension d'isolement (BV_S) de 5.000V_{eff} et garantit des distances de fuite et de dégagement d'au moins 8,0 mm, ce qui en fait un candidat parfait pour les applications nécessitant de bonnes performances d'isolement, notamment les projets à sécurité critique.

En outre, ce nouveau TLP5832 garantit un temps de propagation (t_{PLH} , t_{PHL}) de 200 ns, avec un biais de propagation (t_{Psk}) de ± 80 ns sur toute la plage de température opérationnelle de -40°C à +110°C. Par conséquent, il permet de concevoir des inverseurs à haut rendement, en réduisant les marges de conception liées à la température.

Les livraisons ont commencé.

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

Fondé en 1973 à Neuss en Allemagne, TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Akira Morinaga.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0 Fax : +49 (0) 211 5296 79197

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail : discrete-ic@toshiba-components.com

Pour des informations concernant la publication, contactez :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tél : +44 (0) 282 2832

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par :

Birgit Schöniger, Publitek

Tél : +44 (0) 20 8429 6554

Web : www.publitek.com

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com

Avril 2018

Réf : 7118/A